

証券コード：6599

A large, semi-transparent watermark-like image of a futuristic city skyline is set against a background of a dense, glowing blue circuit board pattern. The city features several skyscrapers of varying heights and architectural styles, some with spires or domes. A bright, circular light source is visible on the right side of the image.

EBRAIN

個人投資家向け I Rセミナー

2025年11月22日(土)
代表取締役社長 上村 正人

- ・ 会社概要
- ・ 事業内容の説明
- ・ 2026年3月期(第53期)上半期決算状況
- ・ 2026年3月期(第53期)通期見通し
- ・ 成長への取り組み

設立	1973年（昭和48年）10月
本社	東京都八王子市石川町
資本金	1億4,301万円
売上高	40億2,500万円（2025年3月期）
経常利益	4億7,500万円（同上）
従業員数	120名（2025年3月現在）
事業所	東京都八王子市、東京都荒川区、埼玉県入間市、大阪市東淀川区
子会社	蘇州エブレン（蘇州惠普聯電子有限公司：中国江蘇省蘇州市）
事業内容	産業用電子機器・工業用コンピュータの設計製造販売

- 現在のメインの仕事内容は、通信・電力・鉄道・医療などの「社会インフラ系設備」および半導体製造装置や生産自動化機械などの「産業インフラ系設備」に、コントローラーとして使用される**産業用コンピューター**の**受託設計**と**受託生産**が中心で、売上の80%以上を占めています。

通信・放送



- 鉄道・電力・通信などの公共性の高い事業会社向け設備の開発や調達は、**大手の装置メーカーが主契約者**となっていて、私たちのビジネスのポジションとしては、その下になります。

鉄道



- 主契約者の装置メーカーは、設備やシステムの開発構想に基づいて、当社へ委託するコンピュータ製品の「要求仕様書」を作成して提示し、私共はその**「要求仕様」に基づいて製品を設計**し、試作品を作って装置メーカーへ送り、評価と設計検証を受けます。

医療

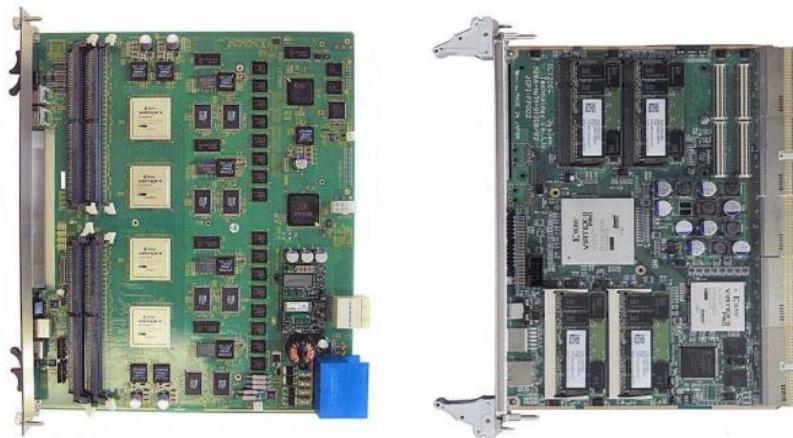


- 量産に入る迄に半年とか一年以上の期間を要する事もありますが、**量産開始以降は中長期的に安定した製品供給**を要求されます。

半導体製造装置



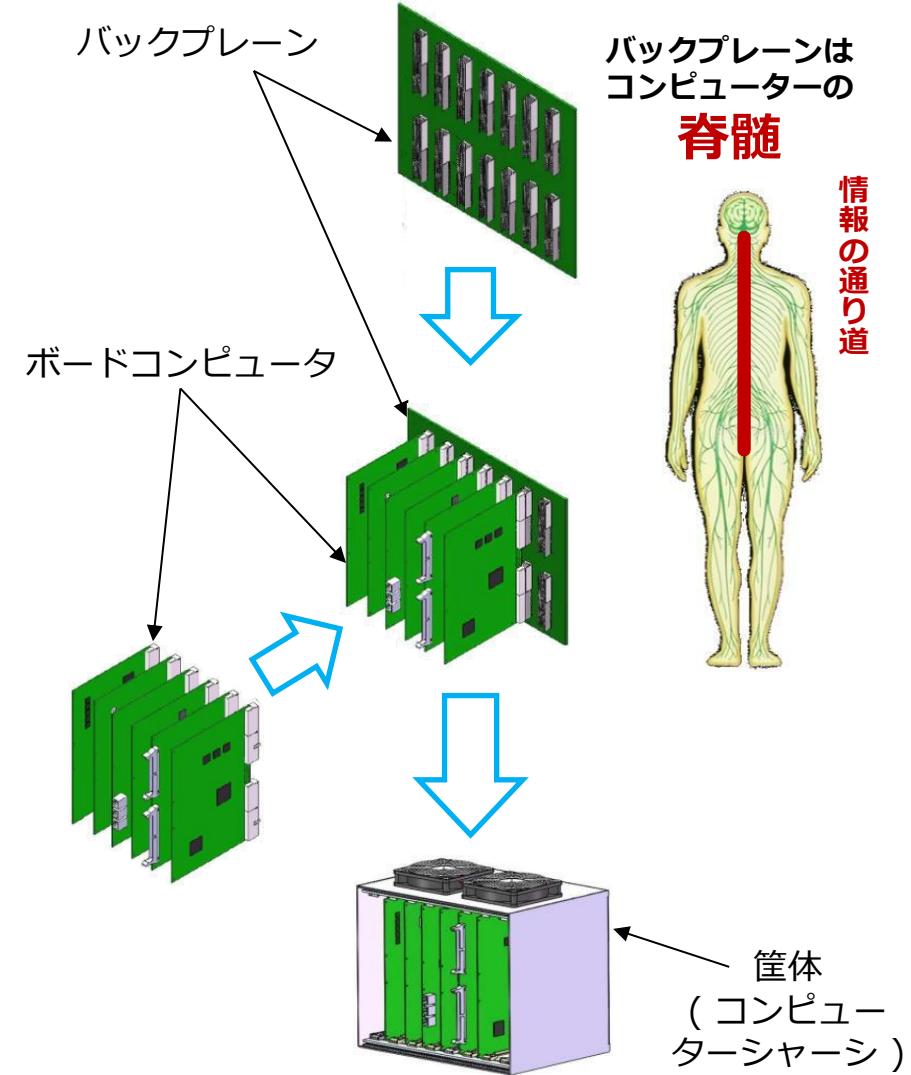
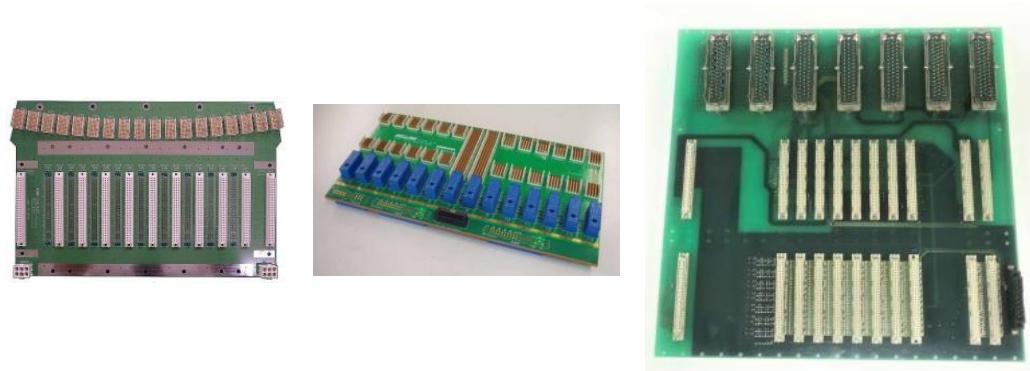
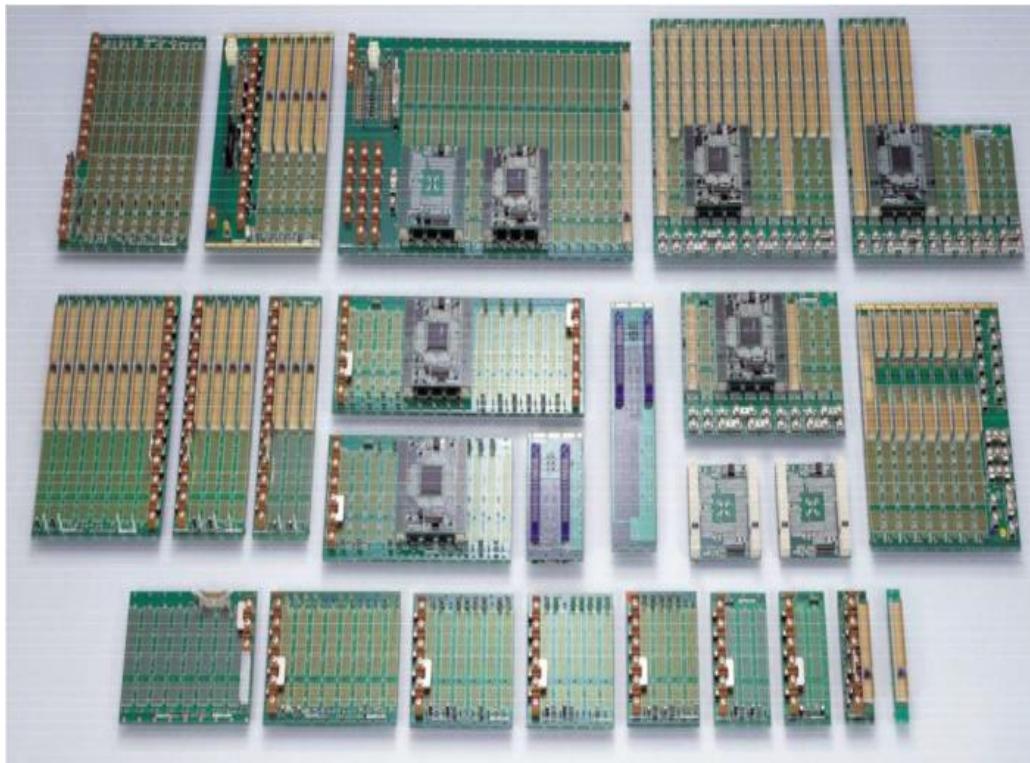
- バックプレーンシステム用
ボードコンピュータ



- IoT・Edge システム用
ワンボードコンピュータ



製品区分(2) バックプレーン

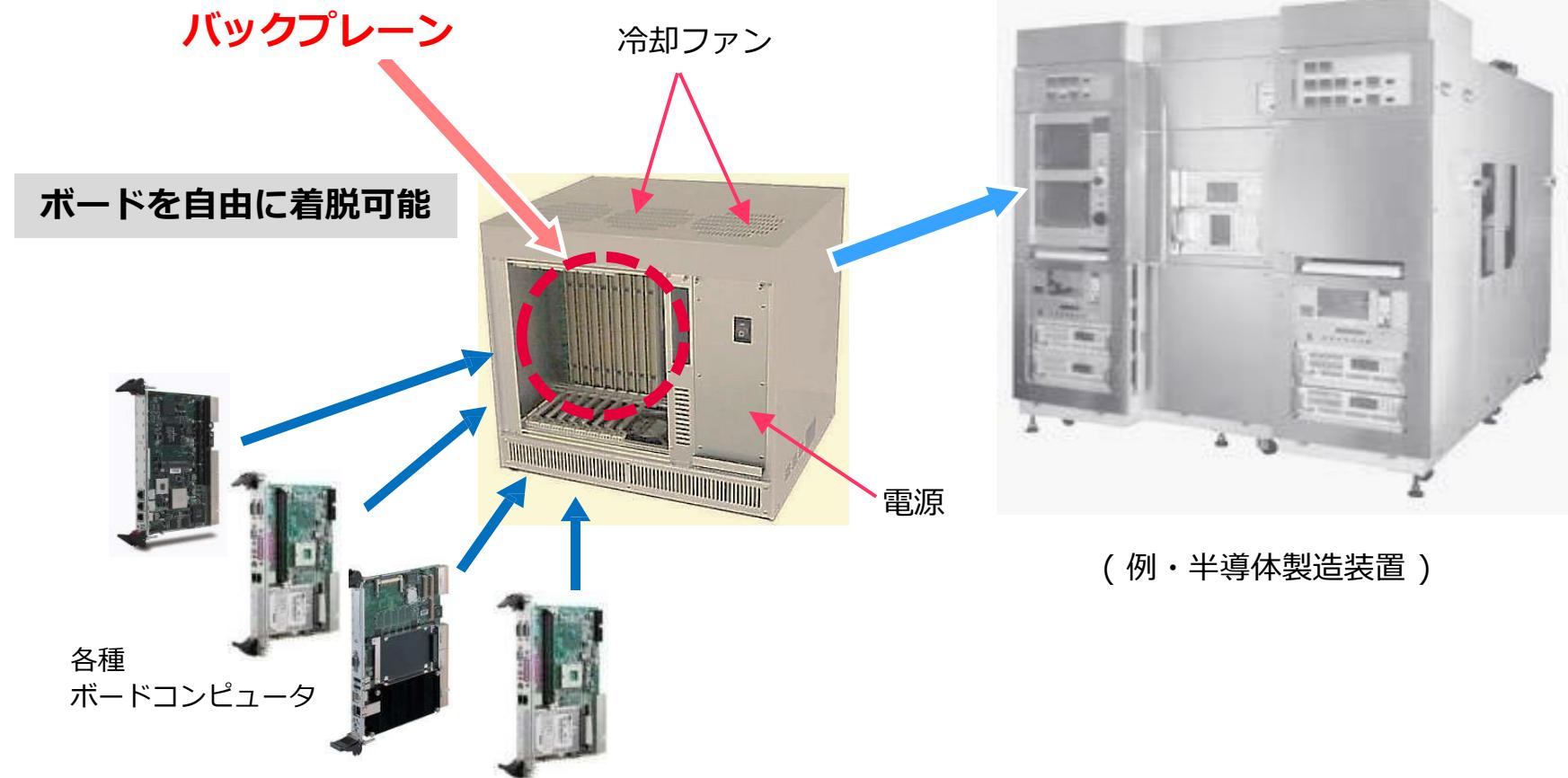


- バスラック
(バックプレーン搭載型シャーシ)



- ワンボード型シャーシ
(IoT・Edgeシステム用)





バックプレーン

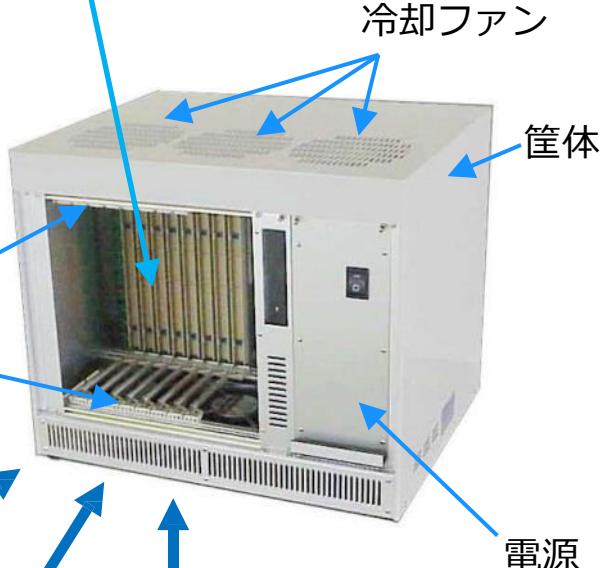
【役割】
各種回路基板を相互に接続して
信号伝送や電力供給を行う



ガイドレール



ボードコンピュータ



【バックプレーン方式の利点】

ボードコンピュータが自在に着脱可能

1.保守性

ホットスワップ、
保守体制、保守要員、

2.拡張性

拡張スロット、増設、
機能追加、

3.汎用性

市場に流通しているボードコンピュータを採用する事が可能。

多くの産業用コンピューターで
バックプレーン方式が採用される

エブレン製品の用途（応用分野）

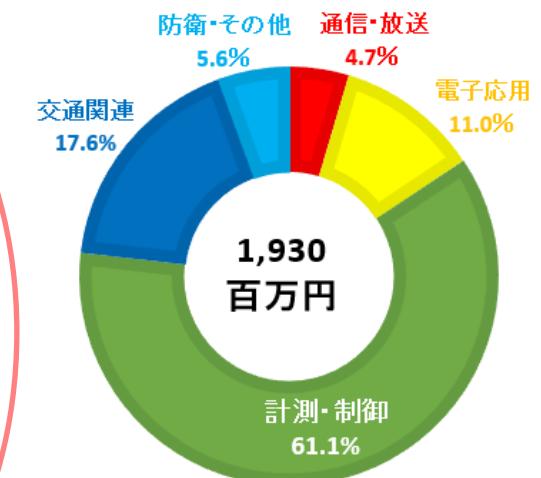
EBRAIN エブレン株式会社

産業インフラ・社会インフラ関連の大手企業と安定的な取引関係を継続

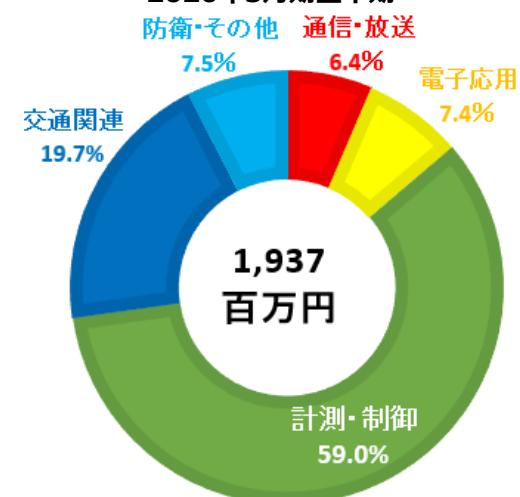


連結売上高構成前年同期比

2025年3月期上半期



2026年3月期上半期



主要納入先 (直接納入,間接納入を含む)

E BRAIN エフレン株式会社

各分野の主要メーカーへ納入



NEC グループ各社



日立製作所
グループ各社



富士通グループ各社



(株) ニューフレア
テクノロジー



GE Healthcare

GE Healthcare
グループ各社



(株) 東京精密



三菱重工
グループ各社



三菱電機
グループ各社



川崎重工業
グループ各社



東京エレクトロン
グループ各社



キヤノンメディカル
システムズ (株)



古河電気工業 (株)



(株) 京三製作所



ギガフォトン



パナソニック
グループ各社



東芝 グループ各社



日本アビオニクス (株)



レーザーテック (株)



日本電子 (株)



(株) SCREENセミコンダクター
ソリューションズ



第一実業ビスウィル (株)



日本信号 (株)



ソニーグローバル
マニュファクチャリング &
オペレーションズ



(株) 明電舎



東京計器 (株)



アンリツ (株)



(株) ニコン



ウシオ電機 (株)



(株) 小野測器

BCPの観点から共通の設備で複数の生産拠点で生産



自社開発のプレスフィットマシンとボード
チェックを八王子、入間、大阪、蘇州の
4拠点に設置、どの生産拠点でも同じよう
に生産できる体制をとっています。



蘇州惠普聯電子有限公司
(中華人民共和国江蘇省)
・設計・開発
・生産

大阪事業所
(大阪市東淀川区)
・設計・開発
・生産

上野事業所
(東京都荒川区)
・設計・開発
本社・八王子事業所
(東京都八王子市)
・設計・開発
・生産

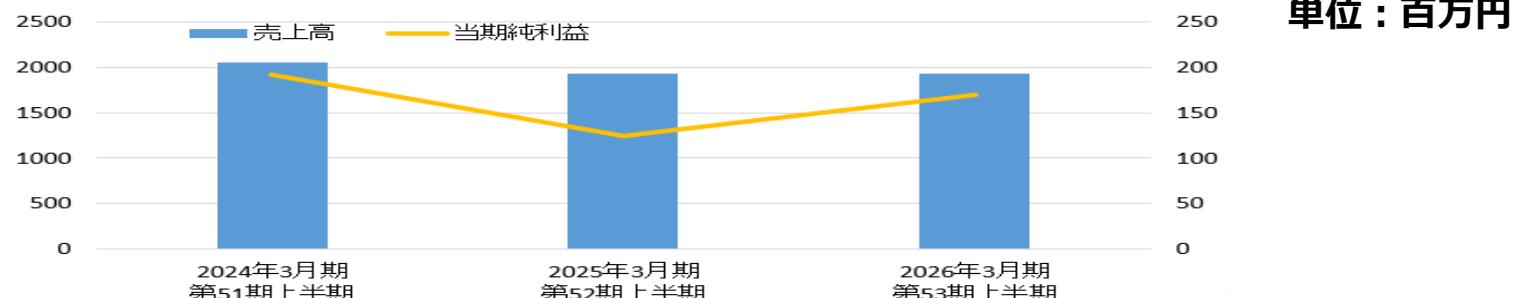
2026年3月期（53期）上半期業績報告

2026年3月期（第53期）上半期決算実績

EBRAIN エブレン株式会社

連結損益計算書	2024年3月期 上半期	2025年3月期 上半期	2026年3月期 上半期 (前年同期比)	上半期計画 (計画達成率)	通期計画 (計画進捗率)
売上高	2,055	1,930	1,937 (100.3%)	1,950 (99.4%)	4,100 (47.3%)
営業利益	287	188	237 (126.3%)	210 (113.3%)	520 (45.7%)
営業利益率	13.9%	9.7%	12.2%		
経常利益	290	189	253 (133.7%)	210 (120.5%)	520 (48.7%)
経常利益率	14.1%	9.8%	13.0%		
当期純利益	192	124	170 (136.7%)	140 (121.7%)	340 (50.1%)
当期純利益率	9.3%	6.4%	8.7%		

売上利益同期比較



計測・制御（半導体製造装置・FA製品等）

- ✓ EV関連への投資減少
- ✓ AI関連等最先端分野以外は低調に推移
- ✓ 売上は前年比**3.2%減**

1,179百万円→1,142百万円（37百万円↓）

交通関連（鉄道・高速道路等）

- ✓ 下期予定案件の納入前倒し要請
- ✓ 売上は前年比**11.9%増**

341百万円→381百万円（40百万円↑）



通信・放送・電力

- ✓ 通信・放送分野の既存案件の生産終了、設備投資減少
- ✓ 電力関連の新規案件量産開始
- ✓ 売上は前年同期比**38.7%増**
89百万円→124百万円（34百万円↑）



電子応用（医療・生命科学・HPC等）

- ✓ 主要顧客での機種更新による売上減
- ✓ 医療関連市場のトレンドは堅調
- ✓ 売上は前年同期比**32.8%減**
213百万円→143百万円（69百万円↓）



防衛・セキュリティー

- ✓ 防衛関連の新規案件成約
- ✓ 防衛予算増額による受注量の増加
- ✓ 売上は前年同期比**35.8%増**
107百万円→146百万円（38百万円↑）

連結応用分野別売上推移

単位：百万円



2026年3月期（第53期）上半期業績 - 財政状態

EBRAIN エブレン株式会社

単位：百万円

	2025年3月	2025年9月	前期末比
流動資産	4,645	4,651	100.1%
固定資産	1,258	1,255	99.8%
資産合計	5,904	5,907	100.1%
流動負債	706	615	87.1%
固定負債	411	417	101.5%
負債合計	1,117	1,033	92.5%
純資産	4,786	4,873	101.8%
負債純資産合計	5,904	5,907	100.1%
自己資本比率	81.1%	81.1%	±0%

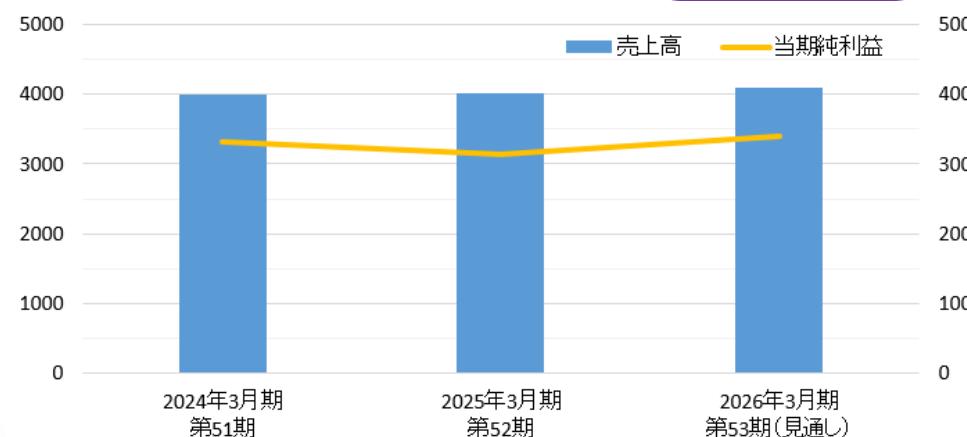
2026年3月期 通期予想 (期初の予想から変更なし)

EBRAIN エブレン株式会社

単位：百万円

連結損益計算書	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期 見通し	増減率
売上高	3,987	4,025	4,100	101.8%
営業利益	486	464	520	111.9%
営業利益率	12.1%	11.5%	12.6%	
経常利益	490	475	520	109.4%
経常利益率	12.2%	11.8%	12.6%	
当期純利益	332	313	340	108.5%
当期純利益率	8.3%	7.7%	8.3%	
1株当たりの配当	33円+5円※	40円	48円	

※創立50周年記念配当（5円）含む





計測・制御（半導体製造装置）

- ✓ SEAJ（日本半導体製造装置協会）が前年度比10%増加を発表
- ✓ AI関連投資とそれ以外で明暗が分れる
- ✓ 各社半導体製造装置メーカーの生産調整は一部継続



交通関連

- ✓ 上期から国内向け案件が予想以上に好調を持続している
- ✓ 通期予算を上回る可能性が高い



通信・放送・電力

- ✓ 電力分野での新規案件量産開始
- ✓ 通信・放送分野は低調に推移する見込み
- ✓ 電力用通信関連分野は堅調



電子応用

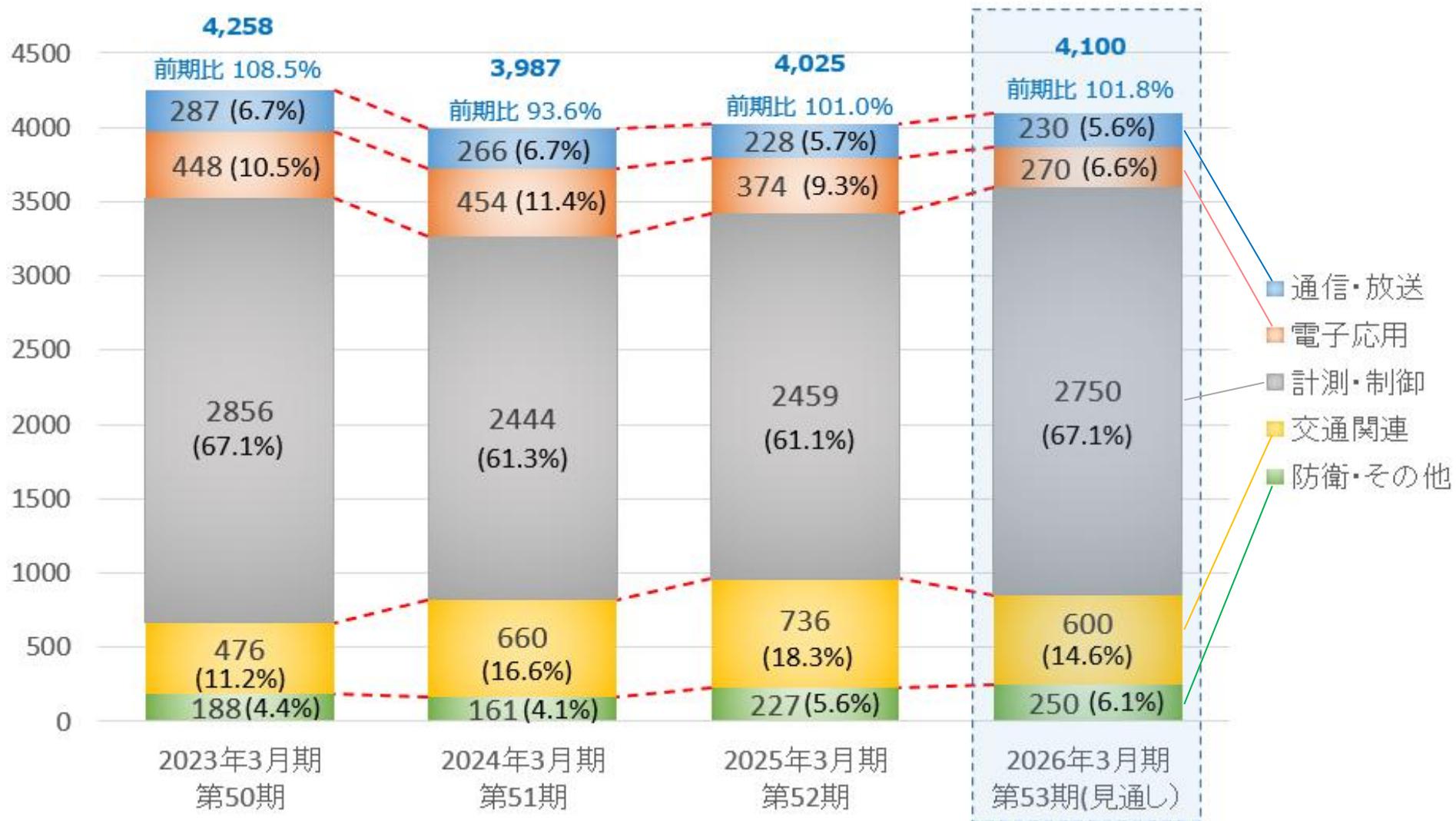
- ✓ 医療機器の一部顧客の機種更新による生産調整が継続する
- ✓ 中国生産製品の機種替えによる生産減少



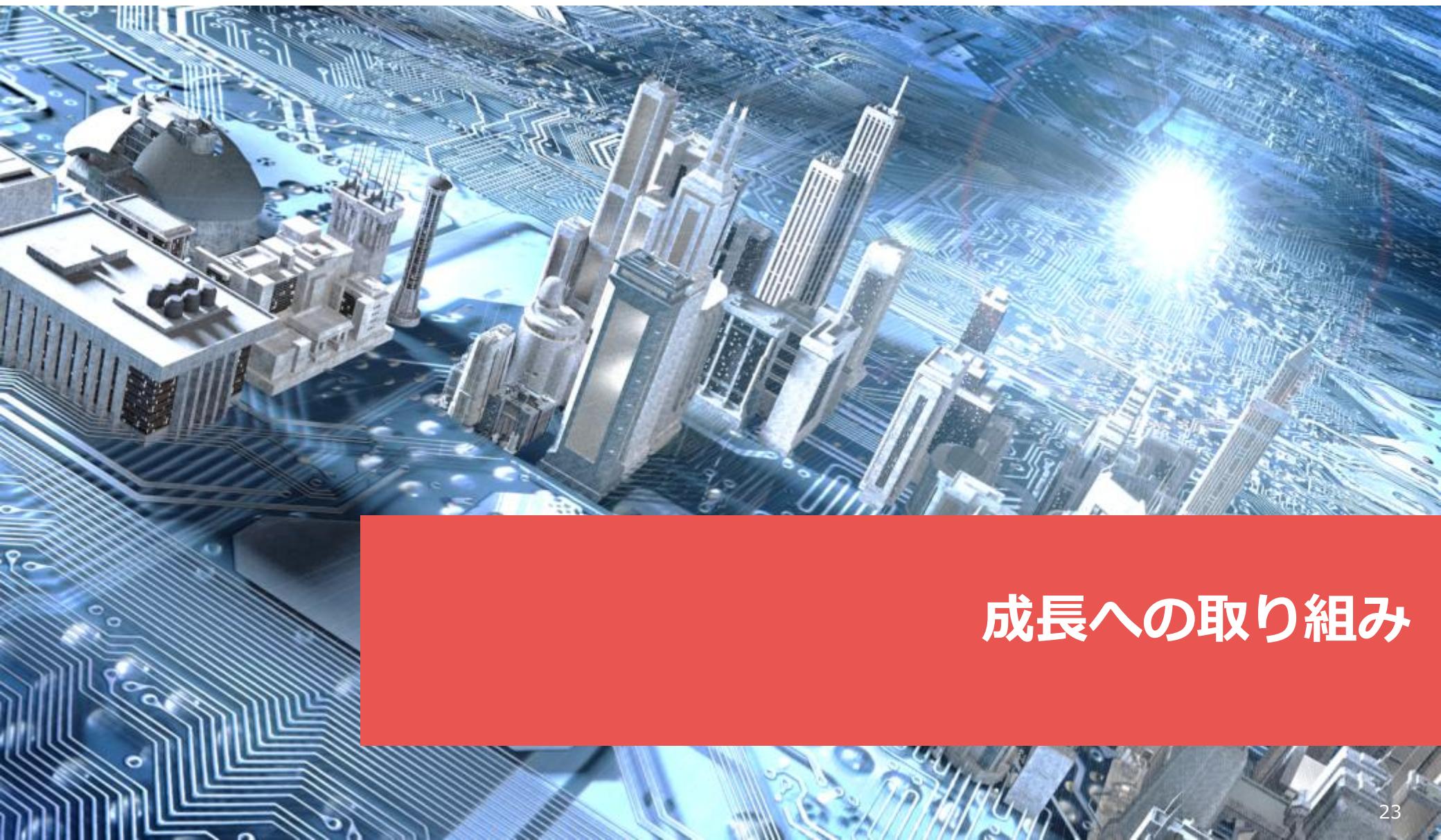
防衛・セキュリティー・その他

- ✓ 案件増加の見込み
- ✓ リピート案件でも受注台数が増加

連結応用分野別売上推移（期初の予想から変更なし） 単位：百万円

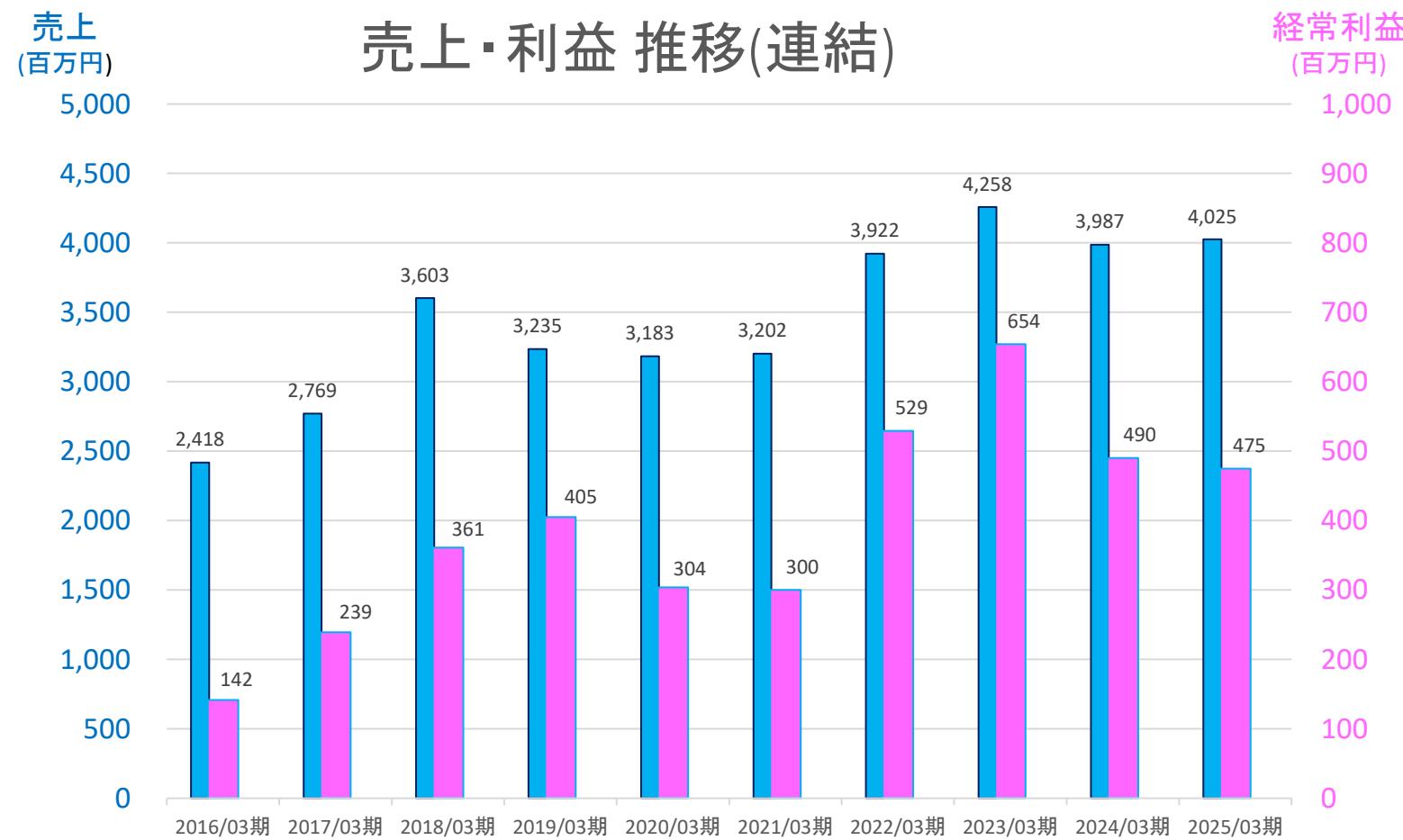


証券コード：6599



成長への取り組み

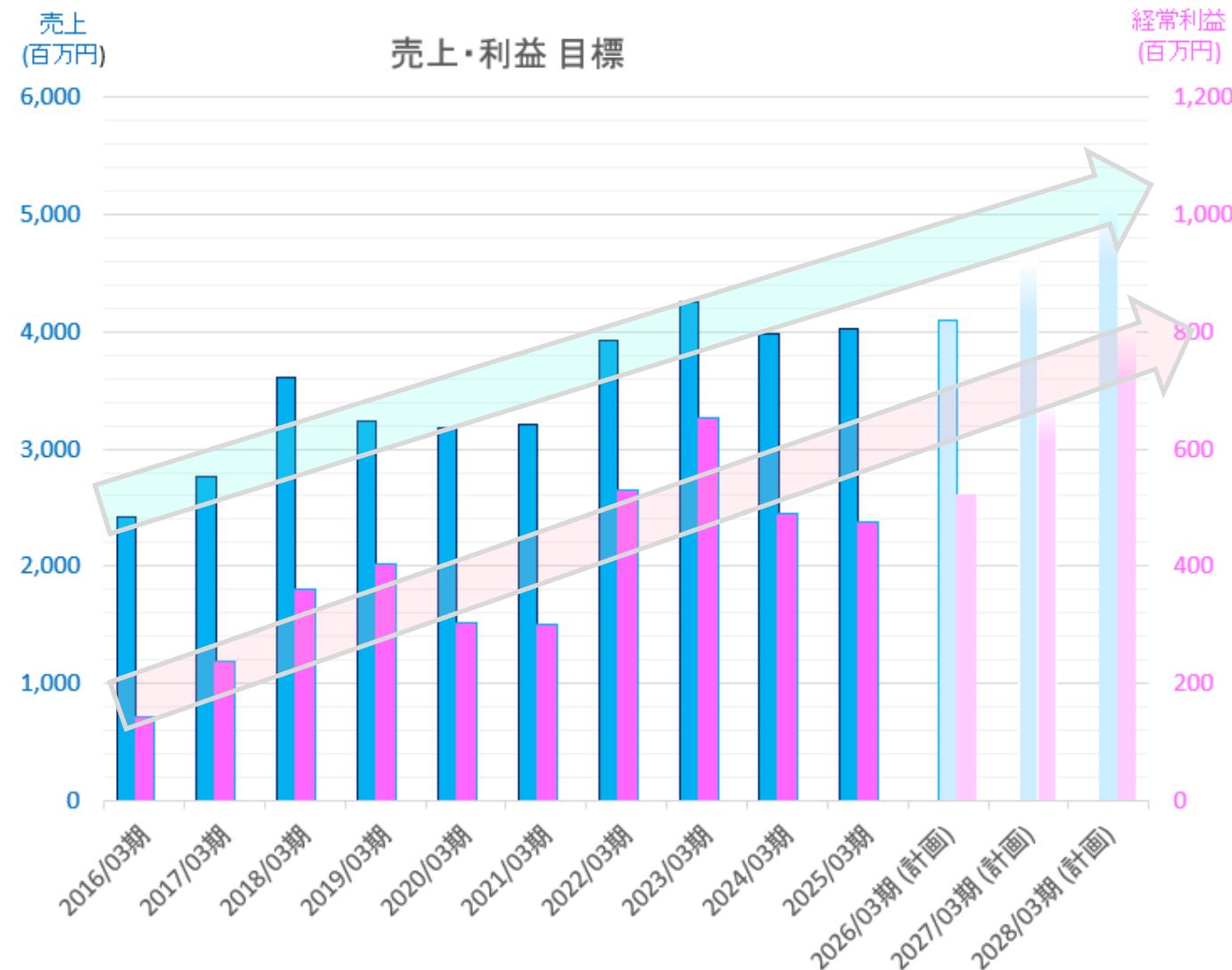
売上：24.1億円→40.2億円 経常利益：1.4億円→4.7億円



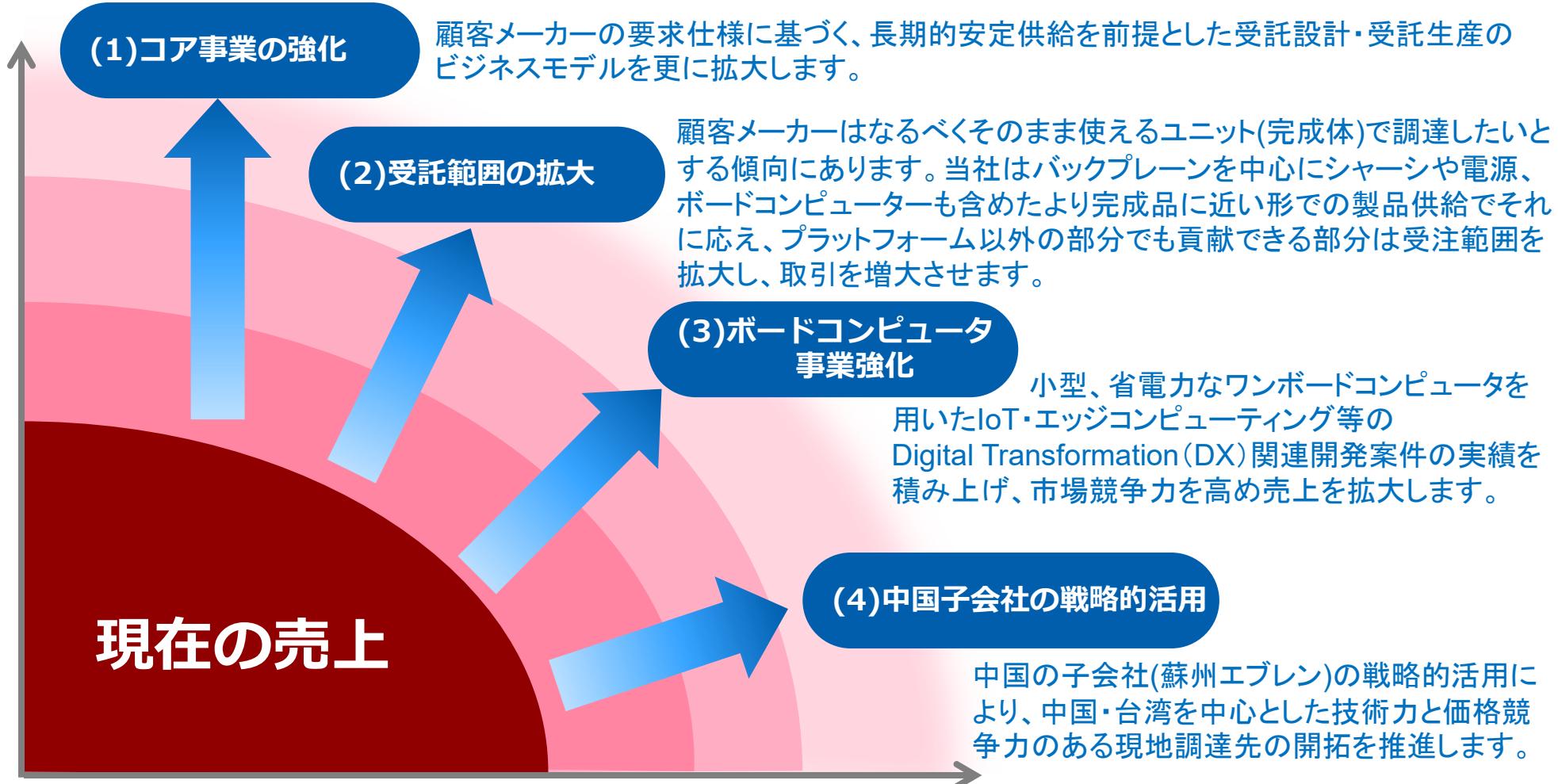
当面の目標

年率10%～15%成長を目標として成長路線を堅持

2028年3月期（55期）に売上51億円、経常利益8億円を目指す



より価値のあるソリューションの提供を通して企業価値の拡大を目指す



(1) コア事業の強化

顧客メーカーの要求仕様に基づく 受託設計・受託生産・長期的安定供給のビジネスモデルを更に拡大します。

大手システムメーカーの動向

過去

大手メーカーは設計・部材調達・生産など全てのプロセスを自社で完結していたが……

製品開発期間短縮の必要性の高まり

慢性的な技術リソース不足

技術の高度化・開発費の増大

今後

「選択と集中」が進み、ノウハウのある専業メーカーとの協業が拡大する

専業メーカーとしての優位性（短納期・低コスト・高品質）を生かし顧客メーカーとの協業を通じてノウハウや設計資産を蓄積



- ・類似案件の受注拡大
- ・事業領域の拡大
- ・要素技術の開発・拡充
(冷却構造、耐電磁波構造 等)
- ・部品共通化による調達力の強化
- ・標準製品、システムパーツの拡充
(FANアラームボード、標準部材 等)
- ・生産拡大に伴う生産設備増強



市場における優位性増大＝事業拡大へ

(2) 受託範囲の拡大

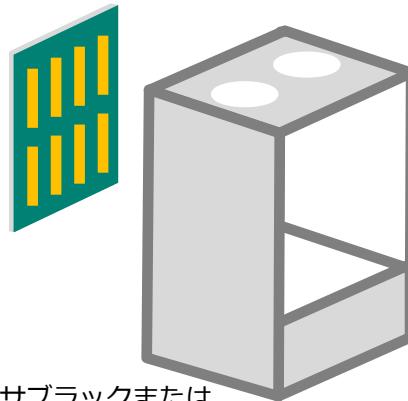
当社の顧客メーカーは、部品をバラバラで調達する事をやめ、なるべくそのまま使えるユニット(完成体)で調達したいとする傾向にあります。

お客様が本来の研究開発活動にリソースを集中していただけるよう、当社の受託範囲がより完成品に近い形となるよう供給体制を整備・拡充し、お客様の多様なニーズに応えます。

バックプレーン・
サブラック・シャーシ

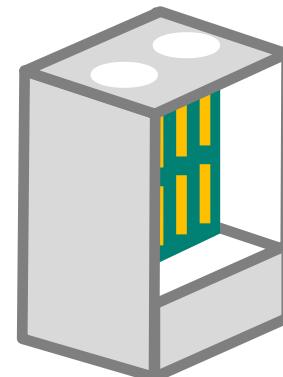
それを単体で提供

バックプレーン



バスラック

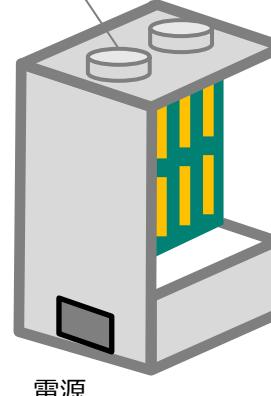
バックプレーンが組込まれた
ラック・ユニット



システムラック

バスラックに電源やファン等を
組込んで結線されたユニット

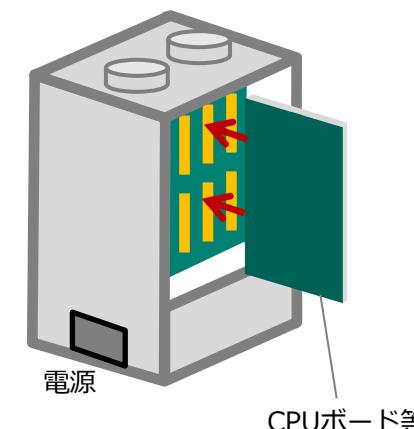
ファン



サブラックまたは
シャーシ

コンピュータ
プラットフォーム

CPU回路を備え、ユーザー側の
目的に応じてI/Oボードやメモリー
ボードを実装して使用できる
ハードウェアプラットフォーム



年々構成レベルの高い（完成品に近い）製品に対する需要が増加する傾向

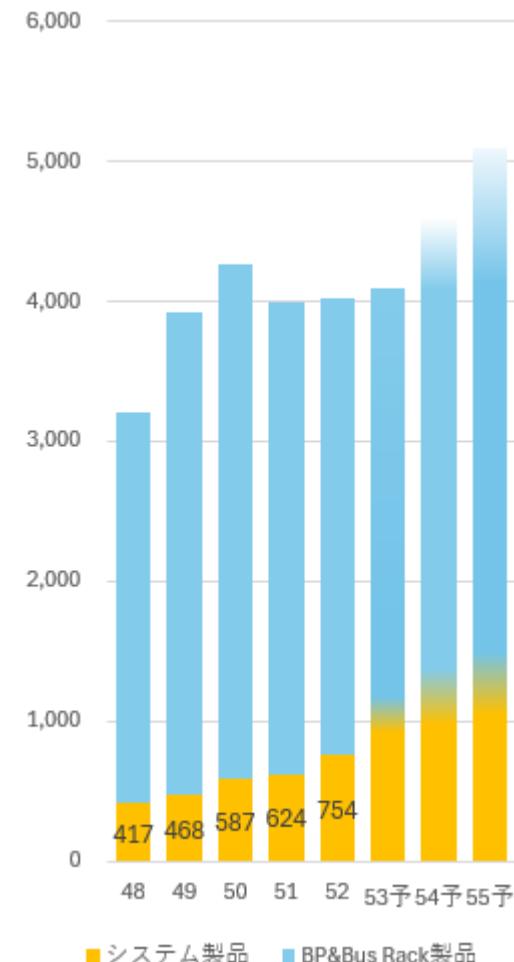
以前から試作を重ねてきた半導体製造装置の主要部位の納入も開始となり
コンピュータプラットフォーム以外の部分で業績拡大

(3) ボードコンピュータ事業強化

技術革新で小型化・低消費電力化が進み、エッジコンピューティング、IoT等、小型ワンボードコンピューターを使用して実現するFAシステム、DX(Digital Transformation)関連の開発案件が増加している。パートナーシップを含む技術部門の増強を図り製品開発力の向上を目指す。

- ・高電圧・大容量直流遮断器（洋上風力発電向送電用途）
- ・半導体検査用制御装置（マイクロプローバー用途）
- ・次世代ワイヤーボンダーコントローラー（システム制御）
- ・信号変換/演算ボード（光学特性検査装置）
- ・高速モーションコントローラー（半導体製造装置用途）
- ・ショットピーニング用AEセンサー・モジュール（FA用途）
- ・半導体製造装置用制御部（ビーム描画装置）
- ・除振装置用コントローラー（精密機械用途）
- ・ECU(Electronic Control Unit)検査装置

※現在進行中の開発案件抜粋



(4) 中国子会社の活用強化

中国の子会社(蘇州エブレン)の戦略的活用により、
中国・台湾を中心とした技術力と価格競争力のある現地の部材調達先の開拓を推進します。
現地企業および日系の進出企業へ現地生産によるコスト競争力のある製品を提供します。

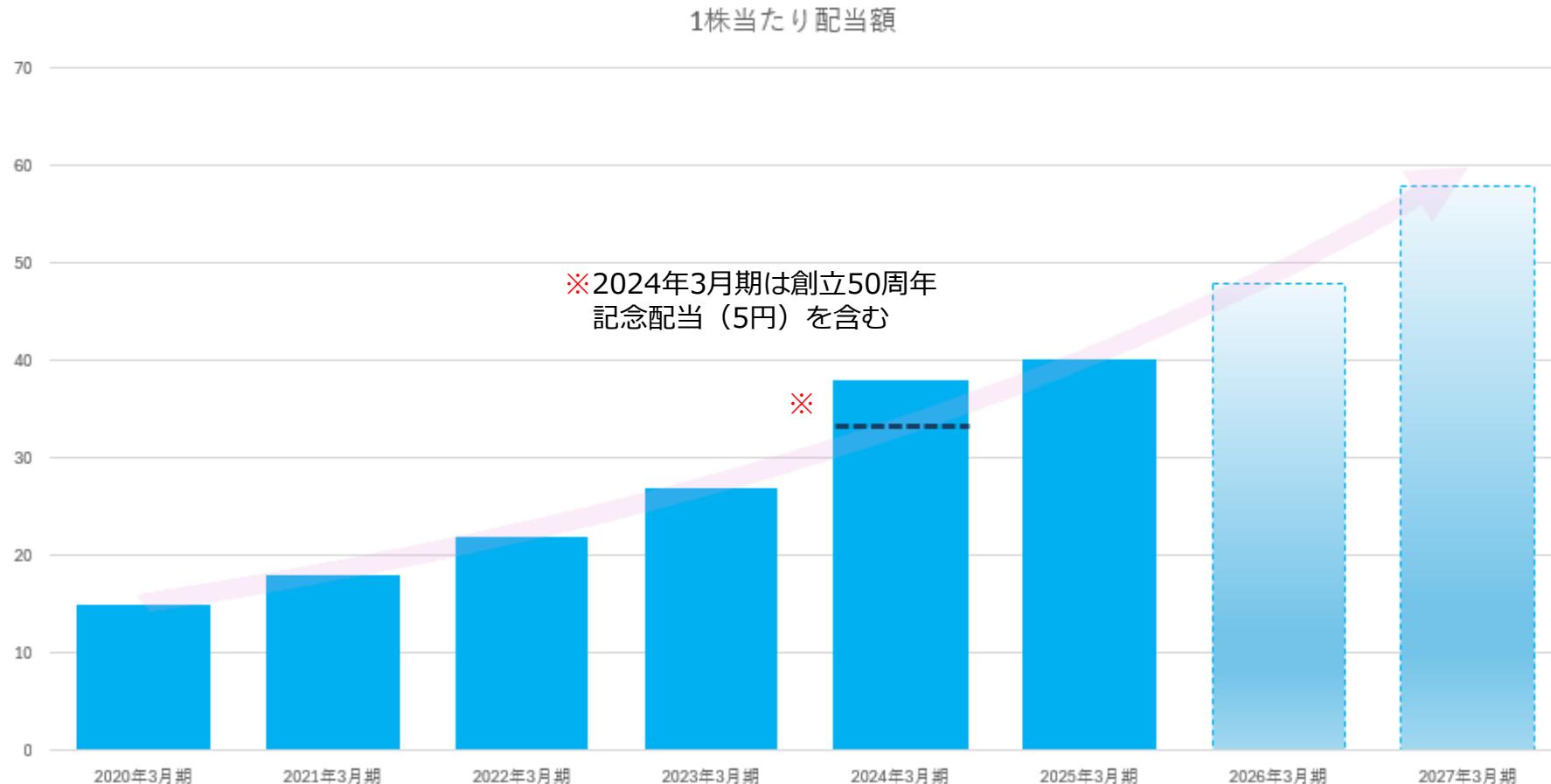


蘇州惠普聯電子有限公司
概要

会社名	蘇州惠普聯電子有限公司
本社所在地	中華人民共和国江蘇省蘇州市
創業開始	2002年9月
資本金	82百万円
株主構成	当社100%
事業内容	バックプレーン及びバスラック等の製造販売及び輸出入、部材の現地生産調達先の開拓

安定した増配を継続

2020年の上場以来増配を継続しています。今後も安定した増配を継続する方針です。



注) 上記グラフは増配を継続した場合のグラフです。実際の配当額は業績等を勘案して決定します。
この配当をお約束するものではありません。

本資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信等は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかる仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値とは異なる可能性があるため、本資料のみに全面的に依拠することは控えていただきますようお願い申し上げます。

また、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。

EBRAIN